

# 5th Atomic Layer Process (ALP) Workshop

<http://www.camt.eng.osaka-u.ac.jp/hamaguchi/ALPWorkshop5/>

日時: 2023年2月10日(金) 午後1時 - 5時半

場所: 大阪大学会館講堂(豊中校舎内) 大阪府豊中市待兼山町1-13

<https://facility.icho.osaka-u.ac.jp/daigaku-hall/index.html>

会議主旨: Atomic Layer Etching および Plasma-Assisted Atomic Layer Deposition 技術の基礎理解し、ガス・材料・プラズマ等の幅広い分野の研究者・技術者が同技術の問題意識を共有することにより、この分野の更なる技術革新を推進することを目的とする。

参加ご希望の方は、事前のご登録をよろしくお願いたします。

事前登録連絡先: 唐橋一浩(karahashi@ppl.eng.osaka-u.ac.jp)

## プログラム概要

講演30, 25分+質疑5分

13:00-13:05	浜口智志 (大阪大学): 開会のご挨拶:趣旨説明
1 13:05-13:40	木野日織(物質・材料研究機構) 新機能材料設計のための自動計算と機械学習用データの生成と活用
2 13:40-14:15	廣瀬文彦(山形大学) 室温原子層堆積法によるナノ周期薄膜形成
3 14:15 - 14:50	石川健治(名古屋大) 原子層エッチング反応の設計と制御
break 14:50-15:05	
4 15:10-15:40	講演者未定 Atomic Layer Etchingのダメージ制御
5 15:45-16:10	伊澤勝(日立ハイテク) ドライエッチング装置を用いた原子層プロセスと課題
6 16:10 - 16:40	本田昌伸(東京エレクトロン) 微細パターニングにおける原子層レベル保護膜を用いたエッチング形状制御技術
7 16:40 - 17:10	安原重雄(ジャパン・アドバンス・ケミカルズ) 原子層プロセスに用いるプリカーサの設計(仮)
8 17:10 - 17:30	西里洋(堀場エステック) ピエゾバルブによる原子層プロセス材料パルス供給の高度化
17:30- 17:35	浜口智志 (大阪大学): 閉会のご挨拶
懇親会 (希望者のみ:会費制:要予約) 会場:未定 会費:5000円	

主催: 大阪大学大学院工学研究科 高等プラズマ科学国際研究拠点

共催: 日本学術振興会(JSPS) 拠点形成事業(Core-to-Core Program)

先端拠点形成型「データ駆動プラズマ科学国際共同研究拠点形成」

ALPワークショップ